

DVS

DIE VERBINDUNGS SPEZIALISTEN

GMM

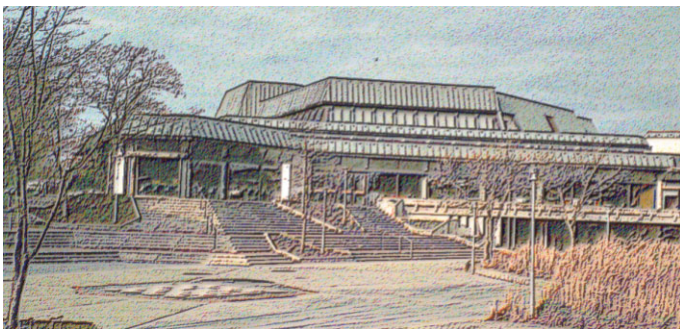
VDE/VDI-GESELLSCHAFT
MIKROELEKTRONIK,
MIKRO- UND FEINWERKTECHNIK

Call for Papers

3. DVS/GMM-Tagung

Elektronische Baugruppen – Aufbau- und Fertigungstechnik – Erfolg durch Innovation

8. / 9. Februar 2006
Schwabenlandhalle Fellbach



Ideelle Mitträger:

ZVEI:



Fraunhofer IZM
Institut
Zuverlässigkeit und
Mikrointegration



Verband der Leiterplattenindustrie e.V.
Korporatives Mitglied im ZVEI

VDI/VDE-IT



www.dvs-ev.de/elektronische-baugruppen2006

ERFOLGREICH FORTFÜHREN !

Mit großem Erfolg wurde im Februar 2002 und 2004 die von DVS und GMM gemeinsam getragene Fachtagung

Elektronische Baugruppen – Aufbau- und Fertigungstechnik –

durchgeführt. Es konnten jeweils deutlich mehr als 200 Teilnehmer zu dieser nationalen Tagung begrüßt werden. Vor diesem Hintergrund soll die verbandsübergreifende Fachtagung gemeinsam mit den national beteiligten Verbänden ZVEI, EITI, VdL, FED, 3D-MID, FG Löten im DVS, GfKORR und DGO sowie dem VDI/VDE-IT und dem IZM im Jahre 2006 in Fellbach fortgeführt werden.

ZIELSETZUNG DER TAGUNG

Die technologischen Trends in der Elektronik gestalten sich mit rasantem Tempo und globalem Ansatz, wodurch sich auch stetig veränderte Kooperationsformen und Möglichkeiten für die Fertigung elektronischer Baugruppen ergeben. Damit stellen sich immer wieder neue Anforderungen an die Aufbau- und Fertigungstechnik von Modulen und Baugruppen. Es genügt heute nicht mehr, einzelne aufbau- und fertigungstechnische Schritte zu betrachten und zu beherrschen, sondern erforderlich wird zwingend eine ganzheitliche Sicht über die gesamte Wertschöpfungskette der Baugruppenfertigung: Design, Technologie, Test. Dabei ist besonders die verstärkte Kombination von modernen Halbleiteraufbautechniken mit neuartigen Substrat- und Leiterplattentechniken über gemeinsame und kostengünstige Integrations- und Montagetechnologien vom direkt kontaktierten Chip bis zur multifunktionalen Leiterplatte zu berücksichtigen (z. B. Heterointegration). Dieser Schwerpunkt, insbesondere in Kombination mit den Produktionsstandorten Deutschland und Europa, steht im Mittelpunkt der Veranstaltung, auch um mit der Diskussion zukünftiger Chancen die bestehende Wettbewerbssituation entscheidend zu verbessern. Dazu gehört z. B. auch die Ablösung von Blei zum 1. Juli 2006 in der Elektronikfertigung.

Im Rahmen der zweitägigen Konferenz sind nach der Plenarveranstaltung zu den Megatrends der Baugruppenentwicklung und -fertigung in den Schwerpunktbranchen ca. 50 Vorträge und eine Posterschau vorgesehen, die das Spektrum vom Design über die Material-, Verfahrens-, und Geräteentwicklung bis zur Qualitätssicherung in der elektronischen Baugruppenfertigung beinhalten. Firmenpräsentationen mit einem kleinen Ausstellungsbereich werden die Konferenz, wie bewährt, begleiten.

Wir laden wiederum alle Fachkollegen ein, sich an der nach Meinung vieler Experten bedeutendsten Veranstaltung der Baugruppenfertigung im deutschsprachigen Raum mit einem Beitrag zu den nachfolgend aufgeführten Themen zu beteiligen.

Bereits heute wissen wir: Fellbach wird wieder ein Highlight für die gesamte Elektronikbranche im Jahre 2006 sein.

Udo Bechtloff

Klaus-Dieter Lang

THEMEN DER TAGUNG

Die Veranstalter laden Fachleute aus der Industrie und den Forschungseinrichtungen ein, einen Vortrag (20 min Präsentation / 5 min Diskussion) oder ein Poster anzumelden. Die Beiträge sollen eines der folgenden Themen behandeln:

Trends der Baugruppentechologie

- ◆ Roadmap für Packages
- ◆ Roadmap der Systementwicklung
- ◆ Multifunktionale Baugruppe
- ◆ Entwicklung der Systemanforderungen nach Branchen (z. B. Automotive; Kommunikation; Space and Avionics; Industrieelektronik; Medizintechnik)
- ◆ WEEE- und RoHS-konforme Materialien und Prozesse
- ◆ Thermisches Management der Baugruppe (Prozessparameter, Wärmeabfuhr, Kühlkonzepte)

Neuentwicklungen bei Substraten und Bauelementen für

- ◆ Hochtemperaturelektronik
- ◆ Hochfrequenzschaltungen
- ◆ Leistungselektronik
- ◆ Höchstintegration

Baugruppenfertigung und Verbindungstechnik

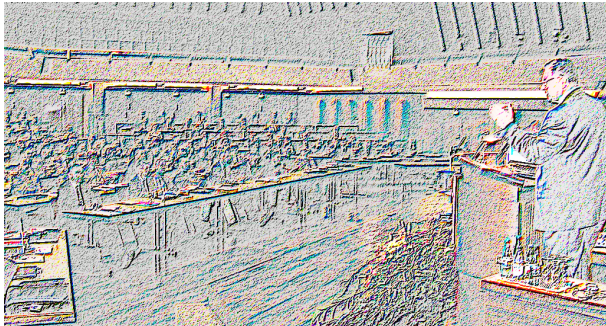
- ◆ Bleifreie Prozesstechnik
- ◆ Löten
- ◆ Kleben
- ◆ Auftragverfahren
- ◆ Bare Die und Chip on Board
- ◆ Einpressverfahren
- ◆ Sonderfügeverfahren
- ◆ Bestückung
- ◆ Schutzlackierung und Verguss
- ◆ Reinigung
- ◆ Montage von Sonderbauelementen
- ◆ Montage auf flexiblen Verdrahtungsträgern
- ◆ Reparatur und Nacharbeit

Prozess- und Produktprüfung

- ◆ Diagnostik (prozessbegleitend) und Qualitätssicherung (z. B. Röntgen, AOI, Ultraschall)
- ◆ Prüftechnik: Teststrategien /-konzepte
- ◆ Methoden zur Verkürzung von Testzeiten
- ◆ Traceability von Prozessparametern

Baugruppenzuverlässigkeit

- ◆ Zuverlässigkeitsbewertung
- ◆ Lebensdauervorhersage



IHRE VORTRAGS- UND POSTERANGEBOTE

Nutzen Sie das Angebot zur Online-Anmeldung Ihres Vortrags- oder Posterangebots unter

www.dvs-ev.de/elektronische-baugruppen2006

Erbeten wird eine ca. 200 Wörter umfassende Kurzfassung. Unbedingt notwendig ist die vollständige Angabe der Adresse des Autors/Vortragenden: Vorname, Name, Firma / Institut, Straße, Postleitzahl, Ort, Telefon, Fax, E-Mail.

Kurzfassungen müssen bis zum

15. Juni 2005

beim Konferenzsekretariat eingereicht werden.

Die Programmkommission wählt die eingereichten Beiträge nach folgenden Kriterien aus:

- ◆ Die Arbeit ist neu und an keiner Stelle des In- und Auslands vor der Tagung veröffentlicht worden.
- ◆ Zielsetzung und Ergebnisse der Arbeit und wie die Arbeit den Stand der Technik voranbringt, müssen klar beschrieben sein.

Die Programmkommission behält sich das Recht vor, als Vortrag eingereichte Beiträge bei der Programmgestaltung in die Posterschau zu nehmen, wenn dies sachlich sinnvoll erscheint (daraus ist **keine** Wertung abzuleiten!).

Die Autoren werden benachrichtigt, ob ihr Beitrag angenommen wurde, und erhalten eine Schreibanleitung für ihr Manuskript sowie eine Dokument-Vorlage, die die notwendigen Formatierungen für das Abfassen des Textes enthält. Posterautoren erhalten zudem die notwendigen Angaben für die Erstellung des Posters.

Die Manuskripte müssen bis zum

7. Dezember 2005

beim Veranstalter vorliegen.

Die Tagungssprache ist Deutsch. Die angenommenen Beiträge werden den Teilnehmern zu Beginn der Tagung zur Verfügung gestellt.

TABLETOP-AUSSTELLUNG

Im Rahmen der Tagung wird wieder Firmen und Instituten die Möglichkeiten geboten, ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot in Form einer Tabletop-Ausstellung einem breiten Fachpublikum zu präsentieren.



Nutzen auch Sie die Gelegenheit!

Aus den Bereichen Forschung, Entwicklung und Fertigung sprechen Sie Fachleute – vom Wissenschaftler bis hin zum Anwender – direkt an.

Aufgrund der positiven Resonanz zur letzten Veranstaltung und der räumlichen Begrenzung ist es empfehlenswert, sich schon frühzeitig einen Ausstellungstisch zu reservieren. Unsere Tagungsorganisation steht Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Kontakt

DVS – Deutscher Verband für Schweißen und
verwandte Verfahren e. V., Düsseldorf
Telefon +49(0)211/1591-302 oder -303
Telefax +49(0)211/1591-300
tagungen@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de/elektronische-baugruppen2006

PODIUMSDISKUSSION UND WORKSHOPS

Neben den Vorträgen und der Posterschau werden eine Podiumsdiskussion und gegebenenfalls Workshops zu aktuellen Themen angeboten.

PROGRAMMKOMMISSION

Vorsitzender der Programmkommission:

U. Bechtloff Gornsdorf

Wissenschaftlicher Tagungsleiter:

K.-D. Lang Berlin

Mitglieder:

A. Biener	Gittelde
K. Bünning	Berlin
J. Denzel	Ulm
R. Dietrich	Kempen
M. Eisenbarth	Ingolstadt
J. Gamalski	Berlin
W. Grönig	Velbert
W. Kempe	Sindelfingen
J. Kostelnik	Rot am See
K. Lindner	Rimsting
S. Mahlstedt	Düsseldorf
E. Maiser	Frankfurt
J. Murawski	Niedernhall
R. Myllylä	Oulu / FIN
J. Nicolics	Wien / A
W. Scheel	Berlin
H. Schenk	Weinheim
R. Schließer	Teltow
G. Schmitz	Stuttgart
H. Schweigart	Ingolstadt
C. Stoppok	Frankfurt
R. Theobald	Frankfurt
H. van 't Hoen	Wirges
J. Weber	Zandt
M. Weinhold	Genf / CH
M. Weinreich	Düsseldorf
W. Witte	Riesa
K. J. Wolter	Dresden

KONFERENZSEKRETARIAT

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Simone Mahlstedt oder Michael Weinreich
DVS – Deutscher Verband für Schweißen und
verwandte Verfahren e. V.
Aachener Straße 172
40223 Düsseldorf
Telefon +49(0)211/1591-302 oder -303
Fax +49(0) 211/1591-300
tagungen@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de/elektronische-baugruppen2006